

## 改善箇所説明図

### 不適合発生箇所

当該製品の構成部品である口金の圧迫・接触・摩擦が原因でヒートシンクの絶縁塗膜剥離が起こり、口金とヒートシンク部が導通。



製品外観



絶縁塗膜の剥離  
(両極が剥離した場合に導電)

### 不具合の内容

当該製品の構成部品であるヒートシンク部の絶縁塗膜の剥離することでヒートシンク部に導通してしまい短絡することがある。このため、最悪の場合、発熱・発火により灯具が損傷するおそれがある。

### 改善内容

ヒートシンク部の絶縁改善を行い、全数対策品で交換する。

### 識別



### 対策前

口金部ロット記号印字 MG 又は MH

### 対策後

口金部ロット記号印字 MG・MH 以外